

オープンタイプ BGA/CSP/LGAソケット フルカスタム GU series Open Type BGA/CSP/LGASocket Full custom GU series

- ・カスタム品の設計製作を行っています。
- ・Custom design welcome.

設計には次の情報が必要です

- IC Packageの寸法図 (公差入り)
リード形状が確認できるもの
- IC Packageの受面高さ等の制限事項
- 基板面積の制限
- センサへの適合形状
- 耐久性
- 温度 (バースインテスト用)、湿度
- 使用信号周波数
- その他

A design requires the following information.

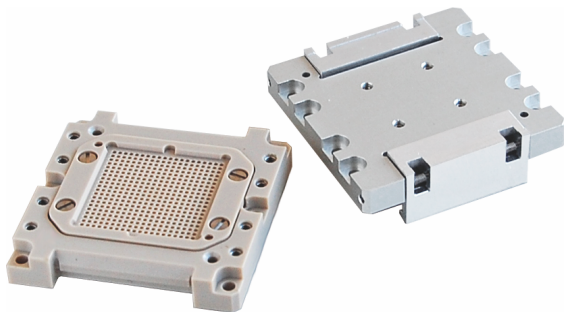
- IC Package's dimension tolerance
リード形状が確認できるもの
- IC Package's seating height and other restrictions
- PCB space's restriction
- Shape through the sensor
- durability
- Temperature (burn-in test), Humidity
- Signal Frequency
- etc.

使用材質例

- ・ガラスエポキシ
- ・エポレト
- ・PEI
- ・PEEK
- ・PAI
- ・MDS
- ・スミカスーパー
- ・AL/タフム処理
- ・ジュラルミン
- ・セラミック
- ・シルバーPEEK
- ・リジッドPEEK
- ・PPS

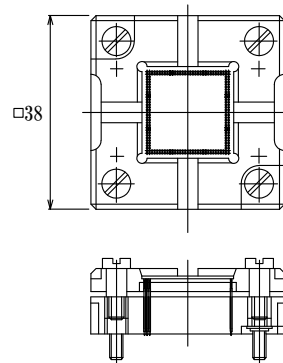
Example of material

- ・Glass epoxy
- ・PET
- ・PEI
- ・PEEK
- ・PAI
- ・MDS
- ・SUMIKA SUPER (LCP)
- ・Aluminum
- ・Duralumin
- ・Ceramics
- ・Silver PEEK
- ・Rigid PEEK



(参考例) Reference example

248極 0.5mmピッチ プローブソケット
0.5 mm of 248 pole pitch Probe socket



GUシリーズのフレームを使用する方法 How to use the frame of GU series

リッドレスタイプ (ユーザーがIC押えをご用意)
A lid-less type (A user prepares IC control)
Mating Configuration

